

证券代码：300400

证券简称：劲拓股份

**深圳市劲拓自动化设备股份有限公司**  
**投资者关系活动记录表**

编号：20220609

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他(请文字说明其他活动内容)
参与单位名称及人员姓名	天风证券 骆奕扬 平安基金 朱春禹 信达澳亚 张凯
时间	2022年6月9日
地点	深圳市劲拓自动化设备股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长/总经理 徐德勇 董事会秘书 张娜
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、董事会秘书介绍公司基本情况。</b></p> <p>公司自成立以来长期专注于从事专用设备的研发、生产、销售和服务。经过二十多年的发展，目前已形成电子热工设备、检测设备、自动化设备、光电显示设备和半导体专用设备等主要产品。</p> <p>公司在电子热工设备已有二十多年积累，相关产品已覆盖电子产品 PCB 生产过程中的插件、焊接、检测等多个流程，为客户提供整套零缺陷焊接检测制造系统和解决方案。公司被行业协会授予“SMT 龙头企业”称号。该类业务客户覆盖面广，主要为众多的电子制造企业。</p> <p>2017年至2019年，公司切入光电显示业务，批量研发交付的代表性产品有指纹模组封装设备、显示模组封装设备及</p>

3D-Lami 贴合设备等，当时率先突破国外技术封锁，并拓展了公司客户类型，增加了面板生产厂和模组生产厂客户。该类业务目前仍有延续，为公司贡献收入。

近几年来，公司顺利切入半导体专用设备领域，研发交付的产品有半导体热工设备和半导体硅片制造设备，率先填补国内市场空白，拓展了公司客户类型，增加了半导体封测厂商、半导体器件生产厂商和半导体硅片生产厂商等。公司于 2021 年分别成立了控股孙公司思立康和至元发展半导体业务。思立康主要发展半导体热工设备，涵盖半导体芯片封装炉、Wafer Bumping 焊接设备、甩胶机、氮气烤箱等。至元主要发展半导体硅片制造设备。

公司自 2014 年在创业板上市以来，经营稳健，规模实现了较大的提升，收入规模从 2.70 亿元增加至 9.89 亿元。公司坚持“专注、持久、分享”的企业理念，持续为投资者、客户、供应商和员工创造长期价值。公司业务从电子热工设备、检测设备、自动化设备扩展至光电显示设备和半导体专用设备，不断进行自我提升和突破，向更高精尖的领域迈进。

公司为国家级高新技术企业、国家工信部制造业单项冠军产品企业，于深圳市自建两个工业园（劲拓自动化工业园和劲拓光电产业园），建筑面积约 10 万平方米，均在投入使用中。两个工业园的建设资金主要来源于公司自有资金，目前公司无有息负债。

## **二、思立康半导体设备的技术来源？目前经营情况、在手订单和未来业务发展规划如何？**

**董事长/总经理：**公司多年来在电子热工设备方面有着领先的热工技术积累，公司电子热工方面的产品荣获国家工信部单项冠军产品认证。基于我们与客户及合作伙伴良好的合作关系，结合客户国产替代的需求，公司将自身热工方面的技术积累扩展应用至半导体热工设备领域。

半导体热工设备已经向 10 多家半导体封测厂商和半导体器件生产厂商供货，截至目前，部分设备已顺利在多家客户验收并复购。思立康已交付的多款半导体热工设备已完成了内部产品的归类、定型及成熟度的确认，形成了规范化的产品系列。

近年各晶圆厂、封测厂扩产的动能非常足，纷纷发布晶圆制造扩产计划，加大资本开支，其中大部分来自半导体设备的开支，国产半导体设备厂商迎来了发展机会。随着国内对于先进封装技术的重视，各种新的先进封装工艺被研发出来，如 3D、ChipLet、SiP 等新工艺。汽车电子和高性能计算等新兴应用，有望持续打开先进封装的成长空间。如公司早期注意到国内 IGBT、IC 载板产能紧张，市场需求空间较大，公司及时与客户对接需求，率先将半导体热工设备的应用领域拓展至 IGBT、IC 载板生产制造领域，其他应用领域如 Wafer Bumping、Clip Bonding、FC BGA 等生产制造领域亦有布局。近期思立康业务进展顺利，正常按照合同订单交付设备。

### 三、至元半导体设备的技术来源？目前的经营情况、在手订单和业务发展规划如何？

**董事长/总经理：**至元的技术来源于公司引入了一批成熟的研发团队，团队主要成员分别具有丰富的设备研发、生产制造和销售经验，促使半导体硅片制造设备的研发和交付进展顺利。目前，半导体硅片制造设备已向客户出货，并已得到部分客户认可验收。

目前至元已有市场领先优势，前期验证阶段因保密级较高，缩小了客户面。后续一方面扩大现有半导体硅片制造设备的销售市场，打入新的半导体硅片制造厂的供应链体系，同时完成该产品系列的产能升级，增加设备价值量；另一方面向更高价值量的同类型设备方向升级。加之国内硅片产业链还存在很多空白，随着国内硅片制造厂商的扩产，会继续推动

对国产半导体硅片制造设备的需求。

#### **四、如何理解半导体设备国产替代的逻辑？公司半导体设备相比国外竞争力如何？**

**董事长/总经理：**国内客户选择国产半导体设备首先是政府政策的大力支持。其次以往客户此类设备多是采购的进口设备，但随着国际关系紧张，近年来客户发现很多国外设备不好买，能买到的国外设备价格也比较贵，交付周期很长，配套服务也跟不上。客户在自身经营方面明显感受发展受到限制、面临压力，进而催生了客户产线国产化的迫切需求。公司半导体专用设备在技术和性能方面已经对标国外厂商，而且和国外设备相比有价格优势，交付周期能够满足客户的需求，也能够及时提供配套的售后服务。

#### **五、公司半导体硅片制造设备主要应用于硅片制造的哪个环节，用于 8 寸还是 12 寸的硅片？**

**董事长/总经理：**硅片制造环节主要包括拉晶、滚磨、切片、倒角、研磨、抛光、最终检测等多个环节，公司半导体硅片制造设备运用于硅片制造的后段环节，目前公司已出货的半导体硅片制造设备用于 12 寸硅片设计，小尺寸的相对会简单些，该类设备向下兼容 8 寸硅片的制造。

#### **六、公司去年第四季度业绩变化的原因？**

**董事会秘书：**2021 年第四季度利润压力主要来源于以下几个方面：1、原控股孙公司精创业绩亏损幅度较大，业绩亏损及坏账计提落在了第四季度，综合影响导致第四季度业绩减少约 2,400 万元。2、公司与部分客户（含头部国产面板厂商、头部国产手机厂商）签订的毛利较低的战略订单，也是在第四季度验收，拉低了第四季度毛利。3、第四季度公司为聚焦主业、腾挪发展空间，清理业务条线，打折销售了部分

库存设备，对本期毛利率也产生了一定影响，第四季度毛利较低。

截止到上年末，公司已处置该孙公司股权，及时止损。公司通过研发更多中高端产品，增加产品附加值；继续强化供应链和生产管理，稳定并降低原材料采购成本，提高投入产出比，继续着力扩展半导体专用设备的应用领域，以期形成新的业绩增长点。

**七、2021 年公司投资活动现金流出主要是投资什么项目？应收账款比较高的原因？**

**董事会秘书：**2021 年公司投资活动现金流出主要是投资大额存单、结构性存款等银行理财。

应收账款同比增加，主要系 2021 年销售收入增加、大客户回款进度因疫情延迟所致。不过公司主要客户的资质比较好，截至本年 4 月末，客户已陆续支付了相关款项。公司应收账款回款情况良好。

**八、公司 2022 年二季度业绩相比一季度如何？有无全年业绩预期？**

**董事会秘书：**2022 年一季度业绩压力主要来源于：国内疫情零星散发和局部聚集性疫情交织叠加，对人员流动、生产和物流造成了干扰，影响企业正常生产经营，应政府疫情防控要求，公司及客户复工复产进度亦不尽相同。疫情影响了部分客户正常的生产经营：①导致公司部分已发货产品验收进度缓慢；②导致部分交付设备无法如期安装调试；③导致部分客户要求延期交付等。疫情也导致了公司员工节后正常返岗受阻，生产备料、出货亦阶段性受到干扰，影响公司订单交付进度。

截至目前公司日常生产已恢复，在手订单金额与上年同期基本持平。随着疫情的缓解，客户对交期比较敏感，公司正在

	<p>结合客户需求，采取多项措施，解决产能产出和出货效率的问题。</p> <p>2022 年全年业绩不好预测，公司是设备厂，业绩情况取决于下游客户电子制造厂、面板厂、封测厂、半导体器件厂及硅片厂的扩产计划和进度。2022 年收入构成也许会有一定的变化，公司资源向战略级半导体业务倾斜，希望半导体专用设备收入能为公司 2022 年业绩增量赋能。</p> <p>现场交流结束后，调研人员参观了公司部分半导体专用设备及光电显示设备生产车间。</p> <p>接待过程中，公司接待人员严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，参与人员按要求签署了《承诺书》。</p>
附件清单（如有）	--
日期	2022 年 6 月 9 日